

## 日月光一〇三年度第三季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 103 年 10 月 30 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇三年度第三季獲利報告，本公司一〇三年第三季之合併營業收入較一〇三年第二季成長 14%，較一〇二年同期成長 17%，為新台幣 66,632 百萬元。茲將日月光一〇三年度第三季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

### 合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	103 年度 第三季	103 年度 第二季	102 年度 第三季	103 年度 前三季	102 年度 前三季
營業收入淨額	66,632	58,615	56,748	179,947	155,698
營業毛利	14,198	12,600	11,587	37,147	30,304
營業淨利（淨損）	8,084	6,600	6,099	19,754	15,105
稅前淨利（淨損）	8,590	6,050	5,368	18,924	13,565
所得稅利益（費用）	(1,237)	(818)	(822)	(2,782)	(2,752)
非控制權益	(148)	(138)	(116)	(405)	(332)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	7,205	5,094	4,430	15,737	10,481
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.82	0.64	0.57	1.98	1.36

### 綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	103 年度 第三季	103 年度 第二季	102 年度 第三季	103 年度 前三季	102 年度 前三季
營業收入淨額	42,211	39,266	37,810	115,828	105,422
營業毛利	12,073	10,588	9,646	30,904	24,593
營業淨利（淨損）	7,348	5,973	5,383	17,531	12,862
稅前淨利（淨損）	8,366	5,779	5,134	18,183	12,743
所得稅利益（費用）	(1,105)	(647)	(661)	(2,322)	(2,142)
非控制權益	(56)	(38)	(43)	(124)	(120)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	7,205	5,094	4,430	15,737	10,481
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.82	0.64	0.57	1.98	1.36

### 半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	53
電腦	12
汽車及消費性電子	35
其它	0
前十大客戶佔營收比重	51

銷售地區別佔比	%
北美	62
歐洲	10
台灣	18
日本	6
亞洲其它地區	4

封裝業務產品組合	%
Advanced Packaging	29
IC Wirebonding	61
Discrete and Others	10
封裝資本支出金額	281 百萬美元
打線機台數	15,994 台

測試業務產品組合	%
後段測試	76
晶圓測試	21
前段測試	3
測試資本支出金額	70 百萬美元
測試機台數	3,295 台

### 電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	55
電腦	17
消費性電子	9
工業用	11
汽車電子	7
其它	1
前十大客戶佔營收比重	87
EMS 資本支出金額	74 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2014 年第四季的業績展望如下：

- 半導體封測事業之整體產能將微幅增加大約 1%，整體產能利用率將由第三季的水準增加大約 1-3%；
- 電子代工服務第四季營運狀況將延續第三季之季成長趨勢；
- 合併營業毛利率將小幅度下滑，而合併營業淨利率將持平。